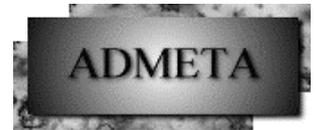


Call for Papers ADMETA^{Plus} 2017



Advanced Metallization Conference 2017: 27th Asian Session

2017年10月18日(水)~20日(金) 東京大学 弥生講堂・一条ホール(本郷)

主催：ADMETA 委員会

共催：公益社団法人 応用物理学会

今回、27回目を向かえる ADMETA では、最先端の配線技術全般を扱う会議として、これまで MPU や各種メモリデバイスの実用化に永く貢献してきました。近年では、シリコンエレクトロニクスを超えた多様なデバイス分野において、低抵抗、高集積、高機能、低コスト、高信頼性を実現する配線技術の重要性は益々増えています。本会議においては、これらの要求に応えるべく、配線関連の材料、プロセス、設計、実装、装置、コスト、分析技術などにフォーカスし、様々な課題解決に向けて基礎から応用開発まで、産学官の研究者、技術者による総合的な議論を行います。本会議を通して、配線技術と関連分野の深耕と新展開を模索し、アジア半導体産業発展への寄与を期待しています。

ADMETA^{Plus} 2017 委員長 中塚 理(名古屋大学大学院)

Conference Topics of Interest

Integration : 配線構造, 配線性能, 配線間容量, 信頼性関連技術, 評価・解析技術 など

Reliability Science and Failure Analysis : EM, SIV, TDD, 欠陥検査, モデリング など

Metallization : 成膜技術 (PVD, CVD, ALD, めっき), バリアメタル, シード, 超臨界, リフロー など

Low-k Dielectric : 成膜方法 (CVD, ALD, SOD), 膜, 界面, 新材料, 構造 (Air gap 他), 評価技術 など

CMP : 平坦化, スラリー, パッド, ドレス, 洗浄, 防食 など

Contact : シリサイド, 浅接合, 界面, 固相反応, 結晶物性, 電子物性, 寄生抵抗 など

MEMS/RF : 配線構造・材料, パッケージング, 製造プロセス, デバイス など

Emerging Technology : アクティブ配線, パワーエレクトロニクス, シリコンフォトニクス, フレキシブルエレクトロニクス, エネルギーハーベスティング など

Backend Devices : 多層配線混載デバイス (MRAM, PCRAM, ReRAM), 電極技術, 磁性・相変化・抵抗変化材料, プロセス など

Nanocarbon Interconnects : グラフェン, ナノチューブ, プロセス, インテグレーション, 信頼性 など

3D and Packaging : TSV, TMV, 形成プロセス, 積層プロセス (COW, WOW), 薄化・平坦化, 接着, バンプ, 応力・熱解析, 封止, 冷却, 信頼性 など

★ 講演概要 :

使用言語 : 英語, 講演形態 : Oral [発表 15 分+質疑応答 5 分 (予定)] もしくは Poster [90 分 (予定)]

★ 応募要項 :

A4, 本文 (1 枚) + 図面 (1 枚), 指定フォーマット。詳細はホームページを参照ください。

- 1) 発表領域 : 「Conference Topics of Interest」より選択ください。
- 2) 発表形式 : Oral/Poster の希望を明示ください。状況によりご希望に添えない場合があります。
- 3) 投稿方法 : Abstract (PDF ファイル), 発表領域・形式を電子メールにて事務局まで送付ください。
- 4) 投稿締切 : ~~2017年6月30日(金)~~ >> **2017年7月13日(木)**
- 5) 採択通知 : **8月14日**までに著者へ連絡いたします。
- 6) Abstract は予稿集として Conference にて配布予定です。参加登録者は **10月16日** (予定) 以降, 会議ウェブサイトからダウンロードも可能です。印刷物をご希望の方には予約販売いたします。
- 7) 採択論文は Japanese Journal of Applied Physics (JJAP) の ADMETA^{Plus} 2017 特集号 (2018 年 7 月発行予定) へ投稿可能です (投稿締切 : 11 月中旬を予定)。通常誌と同様の閲読プロセスにより掲載判定を行います。論文の分類 : Regular Paper (RP), Brief Note (BN), Reviews (RV)*要事前相談

②JJAP 掲載規定に則った原著論文のみを対象とします。多重投稿とにならないようご注意ください。

★ 会議ホームページ : <http://www.admeta.org/>

★ 論文投稿・問合せ先 :

ADMETA^{Plus} 2017 事務局 担当 : 吉田

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-1-7 近江屋第二ビル 502 号室 (株)リアライズ理工センター内

TEL: 03-6801-5685, FAX: 03-6801-5686, E-mail: jimukyoku@admeta.org

ADVANCED METALLIZATION

HP の QR コード

